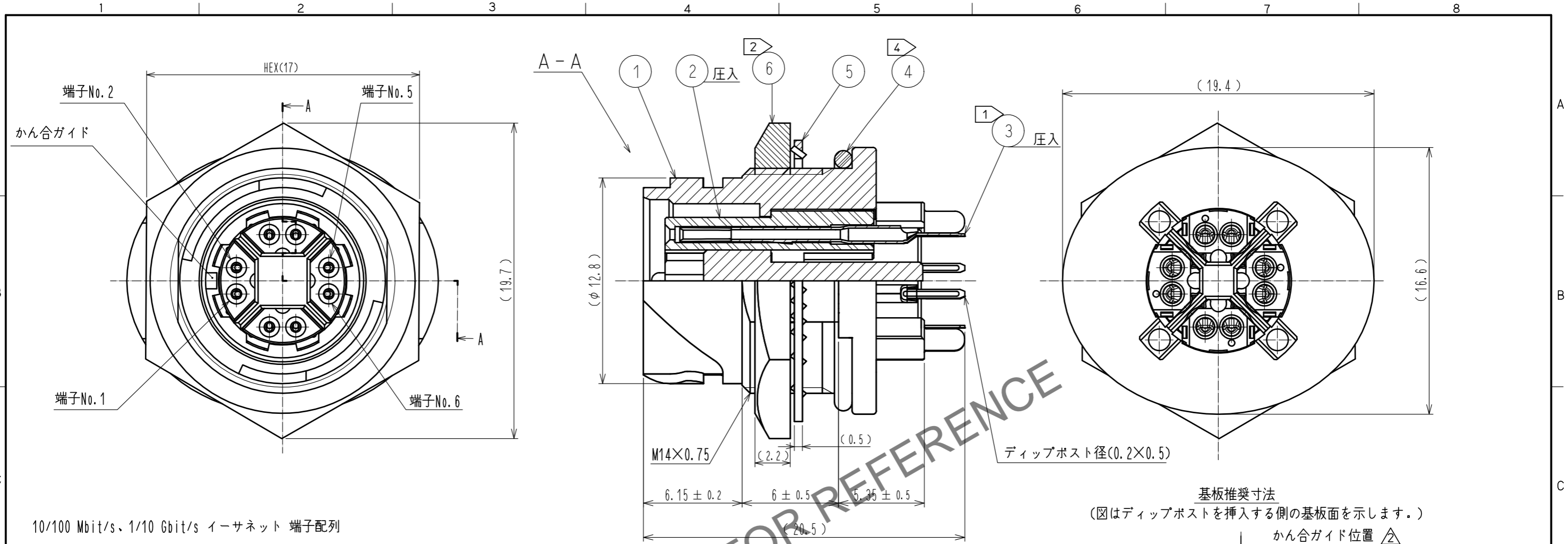
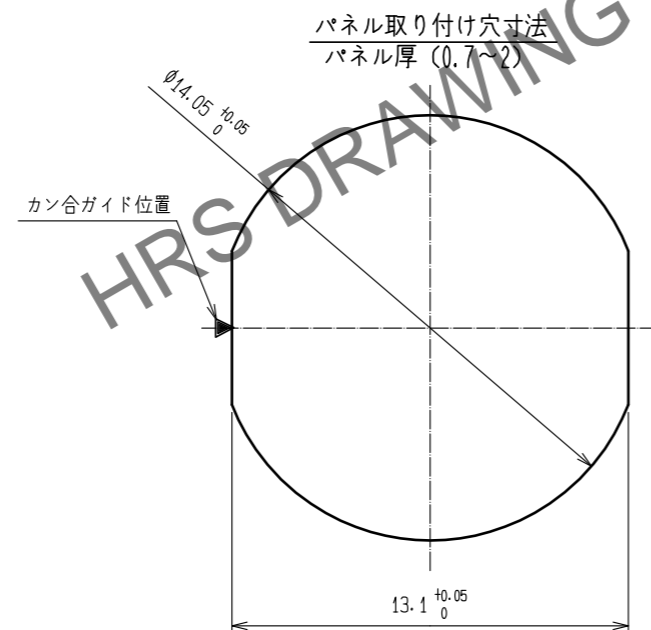


Dec.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

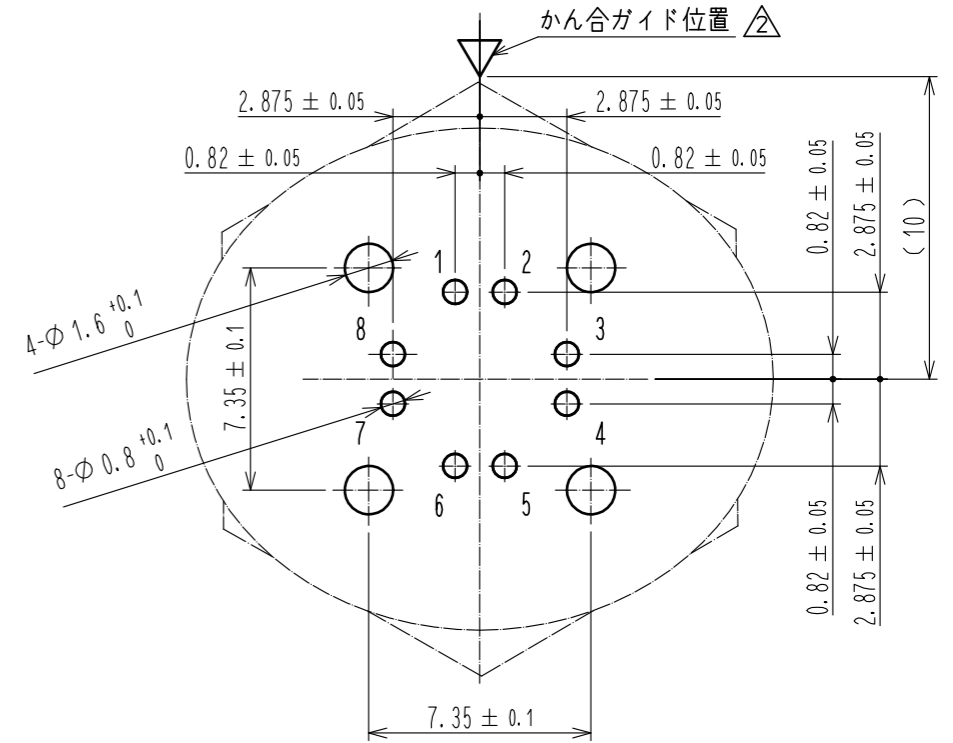


10/100 Mbit/s、1/10 Gbit/s イーサネット 端子配列

端子No.	信号	
	10/100 Mbit/s	1/10 Gbit/s
1	TX+	BI_DA+
2	TX-	BI_DA-
3	N.C	BI_DC+
4	N.C	BI_DC-
5	RX+	BI_DB+
6	RX-	BI_DB-
7	N.C	BI_DD+
8	N.C	BI_DD-



基板推奨寸法
(図はディップポストを挿入する側の基板面を示します。)



- 注 ① 部番③の処理は次による。
 接触部 : 金めっき 0.2μm min.
 ディップ部 : 金めっき 0.03μm min.
 下地 : ニッケルめっき 2μm min.
- ② 部番⑥の推奨締付けトルク : 2~2.5 N・m。
 尚、ねじ部の緩み防水として、部番①のねじ部にヘンケルジャパン(株)製、ロックタイト263、又は相当品を塗布してください。
- ③ 部番③の回転方向は一例を示します。
- ④ 本品を筐体に取り付ける際は、図示のように部番①の溝に部番④が確実に組み込まれている状態で行ってください。
 部番④が外れている、もしくは噛み込まれている場合、防水性が保たれません。
- ⑤ 本品はハーネス手順書 ATAD-C0480-00 に基づき、はんだ結線を行ってください。
- ⑥ 本品の梱包形態は梱包仕様書 ATAP-C0452-00 を参照願います。

3	りん青銅	①	6	黄銅	ニッケルめっき				
2	PPS樹脂	(クロ)	5	りん青銅	ニッケルめっき				
1	亜鉛合金	ニッケルめっき	4	シリコン	(アカ)				
NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH	REMARKS		
UNITS	mm	SCALE	4 : 1	COUNT	1	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
						DIS-C-00018380	SH. KOYAMA	KI. NAGANUMA	20240919
APPROVED : TP. KOMATSU		20230120		DRAWING NO.		ADC-391834-40-00			
CHECKED : KI. NAGANUMA		20230120		PART NO.		LF10WBRBH-8SD(40)			
DESIGNED : KN. IKEHARA		20230120		CODE NO.		CL0136-0058-0-40			
DRAWN : KN. IKEHARA		20230120							